

## ABSTRACT

A sensor unit includes a pressure sensor 1, an acceleration sensor 2 and a signal-processing circuit 3, which are disposed on the bottom surface of a lead 4 to form a line in the longitudinal direction of the sensor unit. The pressure sensor 1 and the acceleration sensor 2 are disposed at respective symmetrical positions with respect to the center of the signal-processing circuit 3 in the longitudinal direction of the sensor unit. Each of the pressure sensor 1 and the acceleration sensor 2 has substantially the same height dimension. The sensors 1, 2, the signal-processing circuit 3 and the lead 4 are sealed with a molded body 8, in such a manner as to allow lead terminals 4a of the lead 4 to protrude outside the molded body 8. The signal-processing circuit 3 is operable, based on a signal from the acceleration sensor 2, to control the ON/OFF action of the pressure sensor 1.

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/019790 A1

(51) 国際特許分類: G01L 19/14, G01P 1/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012270

(22) 国際出願日: 2004 年 8 月 26 日 (26.08.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-301907 2003 年 8 月 26 日 (26.08.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電工株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD.) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 石上 敦史 (ISHIGAMI, Atsushi) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 境 浩司 (SAKAI, Kouji) [JP/JP]; 〒5718686 大阪

府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 飯井 良介 (MESHII, Ryosuke) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 河宮 治, 外(KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 IMPビル 青山特許事務所 Osaka (JP).

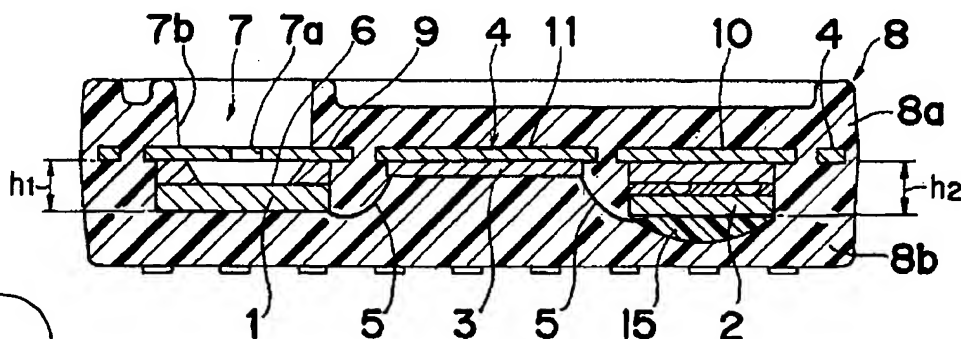
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続葉有/

(54) Title: SENSOR DEVICE

(54) 発明の名称: センサ装置



(57) Abstract: In a sensor device, a pressure sensor (1), an acceleration sensor (2) and a signal processing circuit (3) are disposed on the lower surfaces of leads (4), aligned in a row longitudinally of the sensor device. As seen longitudinally of the sensor device, the pressure sensor (1) and acceleration sensor (2) are disposed symmetrical with respect to the center of the signal processing circuit (3). The pressure sensor (1) and acceleration sensor (2) are substantially equal in height. The two sensors (1, 2), signal processing circuit (3) and the leads (4) are sealed in a molding (8) so that lead terminals (4a) project outside. The signal processing circuit (3) controls the on-off operation of the pressure sensor (1) by a signal from the acceleration sensor (2).

(57) 要約: センサ装置においては、リード(4)の下面に、圧力センサ(1)と加速度センサ(2)と信号処理回路(3)とが、センサ装置縦方向に一直列に並んで配設されている。センサ装置縦方向に関して、圧力センサ(1)と加速度センサ(2)とは、信号処理回路(3)の中心に対して対称な位置に配置されている。圧力センサ(1)および加速度センサ(2)の高さ寸法は、ほぼ同一である。両センサ(1、2)と信号処理回路(3)とリード(4)とは、モールド体(8)により、リード端子(4a)が外部に突出するように封止されている。信号処理回路(3)は、加速度センサ(2)の信号により、圧力センサ(1)のオン・オフ動作を制御する。

WO 2005/019790 A1